



FLUSSMITTEL PRO 334

Typ F-SW 33 ISO 9454 / 1-2.2.3 A

ALLGEMEINE ANGABEN

PRO 334 ist ein spezielles **halogenfreies** Flussmittel nach den internationalen Normen ISO 9454 / 1-2.2.3 A und IPC J-STD-004 für das maschinelle Löten von bestückten elektronischen Baugruppen mit Standardbestückung und/oder der SMT-Anwendung.

PRO 334 hat exzellente Aktivierungseigenschaften an den Benetzungsflächen der Lötpartner, den Bauelementeanschlüssen und Lötzonen der Leiterplatten. Zinnoberfläche erreicht hohen Glanz nach dem Löten. Sehr hoher Zinndurchstieg auch bei mehrpoligen Bauelementen. Die gelöteten Baugruppen sind nach dem Wellenlöten nahezu rückstandsfrei (no-clean!).

PRO 334 bietet den Anwendern durch seine hohe Effizienz einen wirtschaftlichen Vorteil. Die sehr geringen Einsatzmengen erzielen eine große Wirtschaftlichkeit an exzellent gelöteten Baugruppen.

PRO 334 ist für alle automatischen Lötverfahren im Fertigungsbereich der Elektronik geeignet. Die Applikation des Flussmittels auf die bestückte Leiterplatte ist mit allen bekannten Fluxverfahren durchführbar. PRO 334 ist für die Lötung in der Doppelwelle wie auch für Lötungen in der Einfachwelle konzipiert. Das Flussmittel ist während des Lötprozesses thermisch stabil. Damit ist es auch für bleifreie Lötbadern bestens geeignet!

PHYSIKALISCHE DATEN

Farbe	: wasserklar
Flammpunkt	: 13°C
Dichte 20°C	: 0,825 g/cm ³
Feststoffgehalt	: 2,2 %
Halogengehalt	: keiner
Säurezahl	: 28±2
Flussmitteltyp	: ISO 9454/1-2.2.3.A/ IPC-J-STD-004 OR L0
Verdünner	: PRO SOLVENT

Vorheizung:

Die typische Vorheiztemperatur gemessen auf der Bauteilseite der Leiterplatte, sollte 90°C - 120°C betragen.

Lötgeschwindigkeit:

Empfehlenswert ist eine Geschwindigkeit über der Lötwellen von 1,0-2,0 m/min.

Lötbadtemperatur:

Die Lötbadtemperatur für Standardlegierungen sollte 260°C nicht überschreiten.

Lieferform:

Das Flussmittel kommt in 10 Liter und 25 Liter Kunststoffkanistern zur Lieferung.

Besondere Hinweise

Das Flussmittel PRO 334 wurde bezüglich seiner Verträglichkeit gegenüber den in der Elektronikfertigung gängigen Stoffen getestet. Ein Verträglichkeitstest gegenüber den eingesetzten Kunststoffen, Farben und Beschriftungen durch den Anwender ist grundsätzlich zu empfehlen.

Die Eignung der Flussmittelrückstände bezüglich der Funktionssicherheit der Baugruppen unter Betriebsbedingungen sollte vom Anwender überprüft werden. Insbesondere bei Einsatzbedingungen unter hoher Temperatur- und Feuchtebeanspruchung (z.B. >93% rel. Feuchte).

Wenn eine Betauung der Baugruppe, auch kurzfristig, in der Anwendung auftreten kann, müssen entsprechende Feuchteschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

Bezüglich der Lager- und Transportbedingungen sind ebenfalls entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen.

Beim Umgang mit Chemikalien ist zu beachten:

die gesetzlichen Vorschriften (Chemikaliengesetz), besonders die Gefahrstoffverordnung, in der jeweils gültigen Fassung. Die Verpackung und Kennzeichnung unserer Produkte entspricht stets den Bestimmungen dieser Verordnungen und den verkehrsrechtlichen Vorschriften. Für die Entsorgung wird auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt verwiesen.

Sicherheitsvorschriften:

Es wird auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt verwiesen.

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.